

TP800 系列

导热硅胶垫片

TP800导热硅胶片是一款非常高导热性能的材料,表面一致性非常好, 可用于填充小缝隙和不均匀表面, 与各种形状和尺寸的部件进行可靠的接触。低压缩力下表现出较低的热阻和较好的电气绝缘特性。



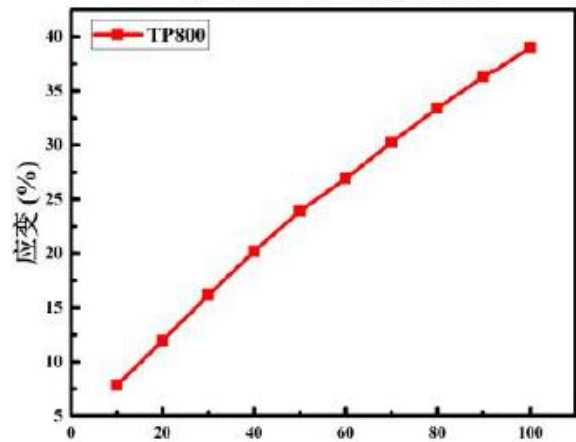
特性与优点

- 导热系数: 8.0 W/m.K
- 自然粘性, 易于使用
- 优秀, 高容量的应用程序
- 高导热系数

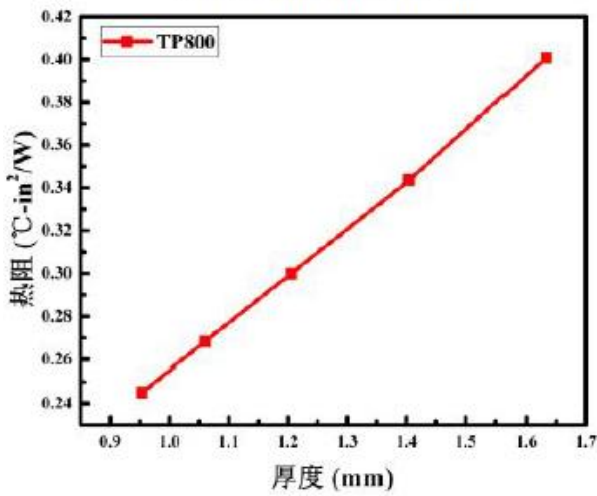
典型应用

- 网络和电信
- It: BGA, ASIC, VRM, 高速存储
- 工业:led, 电源和转换
- 汽车:控制模块, 涡轮执行器
- 消费电子产品:游戏系统、液晶显示器和图形卡

形变量与压力关系图



厚度与热阻关系图



典型属性		
属性	典型值	测试方法
	TP800	-
成分	有机硅+陶瓷	-
颜色	红色	目视
厚度(mm)	0.5~10.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.35	ASTM D792
硬度(Shore OO)	55	ASTM D2240
耐温范围(°C)	-40~150	/
电性能		
击穿电压(kV/mm)	> 6.0	ASTM D149
体积电阻率 (Ω.cm)	10 ¹²	ASTM D257
介电常数@1MHz	7.2	ASTM D150
防火性能	V-0	UL 94
导热性能		
导热系数(W/m.K)	8.0	ISO 22007-2

存储：

- 储存于阴凉、干燥、通风环境

保质期：

- 12个月。